DERWENT-ACC-NO:

1996-185131

DERWENT-WEEK:

199619

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Heat-resistant adhesive used in aerospace and electronics applications etc. - contg. aromatic bis:maleimide, alkenyl phenol and solvent-soluble

polyimide made from silicone di:amine, other di:amine and

acid di:anhydride.

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO BAKELITE CO LTD[SUMB], YOKOHAMA RUBBER CO LTD[YOKO]

PRIORITY-DATA: 1994JP-0200483 (August 25, 1994)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 08060132 A

March 5, 1996

N/A 013

C09J 179/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 08060132A

N/A

1994JP-0200483

August 25, 1994

INT-CL (IPC): C08G073/00, C08G073/12, C09J007/00, C09J007/04, C09J171/00, C09J179/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 08060132A

BASIC-ABSTRACT:

A heat-resistant adhesive is a film-like adhesive, or a sheet-like adhesive impregnated into a textile fabric, or a nonwoven fabric.

The adhesive contains (a) 100 pts. wt. aromatic bismaleimide of formula (1); (b) 58-100 pts. wt. alkenyl phenol of formula (2); and (c) 10-100 pts. wt. polyimide having solubility in a solvent, and synthesised from a silicone

diamine of formula (3), another diamine component and an acid dianhydride, and contg. a siloxane unit, 1-50% based on the total wt.

In (I), X is -CH2-, -C(CH3)2-, -SO2-, -SO-, -CO-, -S- or -O-. In (II), R1 and R2 are each allyl; and n = 1-4. In (III), R3 and R4 are each a 1-5C alkylene, aralkylene or alkenylene, both opt. substd.; R5 and R6 are each a 1-14C alkyl, aralkyl, alkenyl or aryl, both opt. substd.; and n = 1-100.

A prepreg is formed by impregnating (a), (b) and (c) in a reinforcing material.

A resin compsn. is formed by mixing (a) 100 pts. wt. aromatic bismaleimide of formula (1); (b) 58-100 pts. wt. alkenyl phenol of formula (2) dissolving the aromatic bismaleimide; and (c) 10-100 pts. wt. particulate polyimide having a grain dia. of 0.01-100 mum and solubility in a solvent, and synthesised from a silicone diamine of formula (3), another diamine component, and an acid dianhydride, and contg. 1-50% siloxane unit based on the total wt...

USE - Used in aerospace, electronics and sports applications.

ADVANTAGE - Improved heat resistance, formation, tackiness and drape, partic. improved adhesion to Al, Fe, metal- or fibre-reinforced plastics, and has sufficient peeling strength and tensile shearing strength at high temp., at least 170deg.C. Good adhesion is achieved without irregular concn..

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

DERWENT-CLASS: A26 A81 G03 V04 X12

CPI-CODES: A04-A03; A04-B10; A04-B11; A05-H07; A05-J01B; A07-A04E; A07-A04F;

A12-A05; A12-A05B; A12-S08F; G03-B02D; G03-B02E; G03-B04;

EPI-CODES: V04-S02; X12-E02B;

(12) 公開特許公報(A)

(11) 許出數公開番号

特開平8-60132

(43)公開日 平成8年(1996)3月5日

(51) Int.CL* C 0 9 J 179/00 C 0 8 G 73/00 73/12 C 0 9 J 7/00 7/04	NTB	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
.,	- 	審查請求	未請求 請求羽	町の数5 OL (全 13 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特膜平6-20048 3		(71)出職人	000008714 横浜ゴム株式会社
(22)出廣日	平成6年(1994)8月	125日	(71)出版人	東京都港区新橋5丁目36番11号 000002141 住友ペークライト株式会社
			(72)発明者	東京都品川区東品川2丁目5番8号 吉川篇志 神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株 式会社平塚製造所内
			(72)発明者	伊藤友裕 神奈川県平塚市迫分2番1号横浜ゴム株 式会社平塚製造所内
			(74)代理人	弁理士 渡辺 望稔 (外1名)

(54) 【発明の名称】 耐熱性接着剤、プリプレグおよび樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】耐熱性、成形性、接着性、タック性・ドレーア 性等の取扱作業性に優れるポリイミド/ビスマレイミド 系接着剤、及び上記の特性の他に報性に優れ、ポリイミ ド/ビスマレイミド樹脂が有する諸特性をも有し、航空 宇宙分野等の先端技術分野において有用なポリイミド/ ビスマレイミド系複合材料を提供することを目的とす る。

【楠成】(A)下記式[1]で表される芳香族ビスマレイミド100重量部、(B)下記式[2]で表されるアルケニルフェノール58~100重量部及び(C)全重量のうち50%以下1%以上のシロキサン単位を含む下記式[3]で表されるシリコーンジアミン及び他のジアミン成分と酸二無水物から合成される溶剤可溶性ポリイミド10~100重量を含有するフィルム状接着剤、または織布あるいは不識布に含浸したシート状接着剤。【化1】

最終質に続く

(式中、Xは、-CH₂、-C(CH₃)₂、-SO₂、-SO-、-CO-、-S-または-O-を示す。)

$$(R^1)_n$$
HO—Y— $(R^2)_n$
 \cdots at [2]

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)下記式[1]で表される芳香族ビスマレイミド100重量部;(B)下記式[2]で表されるアルケニルフェノール58~100重量部;(C)全重量のうち50%以下1%以上のシロキサン単位を含む、下記式[3]で表されるシリコーンジアミンおよび他のジアミン成分と酸二無水物から合成される溶剤可溶性ポリイミド10~100重量を含有するフィルム状接着剤、または轍布あるいは不機布に含浸したシート状接着剤。

(式中、Xは、-CH₂、-C(CH₃)₂、-SO₂、-SO-、-CO-、-S-または-O-を示す。)

…式[2]

(式中、 R^1 または R^2 は、それぞれ独立にアリル基を表し、 $nは1\sim$ 4の整数を表す。)

【化3】

(式中、R³ およびR¹ は、それぞれ独立に炭素数1~ 30 5のアルキレン基、アラルキレン基およびアルケニレン基を表し、互いに同じであっても異なってもよいし置換されていてもよい。R⁵ およびR⁶ は、それぞれ独立に、炭素数1~14のアルキル基、アラルキル基、アルケニル基およびアリール基を表し、互いに同じであっても異なってもよいし置換されていてもよい。nは1~1 00の整数を表す。)

【請求項2】前記(C)の溶剤可溶性ポリイミドの粒径が0.01~100μmの微粒子である請求項1に記載の接着剤。

【請求項3】(A)下記式[1]で表される芳香族ビスマレイミド100重量部;(B)下記式[2]で表されるアルケニルフェノール58~100重量部;および(C)全重量のうち50%以下1%以上のシロキサン単位を含む、下記式[3]で表されるシリコーンジアミンおよび他のジアミン成分と酸二無水物から合成される溶剤可溶性ポリイミド10~100重量部を補強材に含浸させたプリアレグ。

[化4]

(式中、Xは、-CH $_{2}$ 、-C(CH $_{3}$) $_{2}$ 、-SO $_{2}$ 、-SO $_{3}$ 、-SO $_{4}$ 、-SO $_{4}$ 、-SO $_{5}$ 、-SO $_{5}$ 、-SO $_{5}$ -SO $_{5}$

(式中、 R^1 または R^2 は、それぞれ独立にアリル基を表し、nは $1\sim4$ の整数を表す。)

【化6】

$$H_2N - R^3 - SI - Q - SI - R^4 - NH_2$$
 $R^6 - R^6 - R^6 - NH_2$
... ± 13

(式中、R³ およびR⁴ は、それぞれ独立に炭素数1~ 5のアルキレン基、アラルキレン基およびアルケニレン 基を表し、互いに同じであっても異なってもよいし置換 されていてもよい。R⁵ およびR⁶ は、それぞれ独立 に、炭素数1~14のアルキル基、アラルキル基、アル ケニル基およびアリール基を表し、互いに同じであって も異なってもよいし置換されていてもよい。nは1~1 00の整数を表す。)

【請求項4】前記(C)の溶剤可溶性ポリイミドの粒径が0.01~100μmの微粒子である請求項3に記載のアリアレグ。

【請求項5】(A)下記式[1]で表される芳香族ビスマレイミド100重量部、(B)下記(A)を溶解することのできる下記式[2]で表されるアルケニルフェノール58~100重量部および(C)全重量のうち50%以下1%以上のシロキサン単位を含む下記式[3]で表されるシリコーンジアミンおよび他のジアミン成分と酸二無水物から合成される粒径0.01~100μmの微粒子化した溶剤可溶性ポリイミド10~100重量部を混合してなる樹脂組成物。

【化7】

(式中、Xは、-CH₂、-C(CH₃)₂、-SO₂、-SO-、-CO-、-S-または-O-を示す。)

40

(式中、R1 またはR2 は、それぞれ独立にアリル基を 表し、nは1~4の整数を表す。)

【化9】

$$H_2N - R^3 - SI - O - SI - R^4 - NH_2$$
 $R^6 - R^6 - R^6 - NH_2$
 $R^6 - R^6 - NH_2$
 $R^6 - R^6 - NH_2$

(式中、R3 およびR4 は、それぞれ独立に炭素数1~ 5のアルキレン基、アラルキレン基およびアルケニレン 基を表し、互いに同じであっても異なってもよいし置換 10 されていてもよい。R5 およびR6 は、それぞれ独立 に、炭素数1~14のアルキル基、アラルキル基、アル ケニル基およびアリール基を表し、互いに同じであって も異なってもよいし置換されていてもよい。nは1~1 00の整数を表す。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、耐熱性、成形性、接着 性、および靱性に優れたポリイミド/ビスマレイミド系 樹脂を用いる接着剤および複合材料に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、航空宇宙分野やエレクトロニクス 等の先端技術分野、あるいはスポーツ用途においても多 くの高機能材料(樹脂)が、絶縁材料、接着剤、あるい は複合材料等の素材として使用されている。これらの分 野における技術の急速な進展に伴い、機械強度、電気的 特性、耐薬品性、成形性に優れた素材あるいは材料を閉 発する要請が高まっている。従来、使用されてきた有機 合成高分子系接着剤としては、エボキシ系樹脂、アクリ ル系樹脂、フッソ系樹脂、フェノール系樹脂、ポリエス 30 テル系樹脂、シリコーン系樹脂等を含む接着剤が挙げら れるが、これらの接着剤は、以下の様な問題点を有して いる。すなわち、成形温度等での成形性(作業性)、比 較的低温での接着性には優れるものの高温時の接着強度 や耐久性、信頼性に問題がある。また、ポリイミドは多 くの有機材料(樹脂)の中でもきわだって高い耐熱性を 有しているが、近年、その優れた耐熱性、機械的強度、 電気的特性、耐薬品性等の諸特性から先端技術分野での 使用が増加してきている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ポリイ ミドは上記の様な優れた特性を有する反面、閉環状態で はほとんど溶融流動性を示さなくなるため、成形性(作 業性) が悪い、脆い、接着剤として使用した場合に接着 不良による剥離強度が低いといった問題点を抱えてい る。ポリイミドの前駆体であるポリアミック酸を溶剤に 溶解して用いる方法もあるが、閉環反応でイミド化した 時に副生成物が生成すること、溶剤を除去しなければな らないこと、接着剤として使用したときに接着不良を起 するために、最近、閉環反応でイミド化した状態でも溶 融流動性を示すポリイミドが、米国特許第4、094. 962号明細書、特開昭61-55, 177号公報等に 開示されている。しかし、これらの公報に記載されたボ リイミドでは、成形温度を300℃以上にしなければ十 分な接着力が得られず、成形性に問題を残している。 【0004】また、従来、接着性の信頼性の点から航空 機分野ではエポキシ樹脂やゴム変性エポキシ樹脂系接着 剤が比較的低温の部位に用いられ、構造部材の接合には リベットや溶接が用いられてきた。しかし、高速巡航や 軽量化の要請が強まるにつれて、高い強度を有し、高温 耐熱性、成形性の優れた接着剤が望まれている。こうし た要望に対しては、従来のエポキシ樹脂のシート状接着 剤では耐熱性の点で限界があり、より高い耐熱性が必要 とされる分野においては対応することが困難である。ま た、耐熱性に優れるマレイミド樹脂組成物を用いる方法 もあるが、耐熱性は向上するものの形成される塗膜が脆

く、機械的強度が低下するため、結果として接着力が大

幅に低下するという問題が生じる。

4

20 【0005】さらに、ポリイミドを複合材料のマトリッ クス樹脂へ適用する場合、成形加工性に問題がある。複 合材料のマトリックス樹脂としてはビスマレイミド樹脂 が注目されているが、この樹脂は耐熱性は高いが靱性が 乏しいという欠点がある。ビスマレイミド樹脂のこうし た欠点を改良するために、ゴム成分や熱可塑性樹脂を配 合する方法、他のモノマーを共重合する方法などが提案 されている。これらの方法では、ビスマレイミド樹脂の 耐熱性等の物性が低下する大きさの割りには靱性の向上 が不十分であったり、樹脂単体の破壊靱性は一応向上す るものの複合材料としたときの靱性の向上が十分でな い。また、インターリーフと呼ばれる一種の接着層ない しは衝撃吸収層を層間に挿入する方法も提案されている が、繊維含有率を上げることができない、あるいは取扱 性が悪いといった問題点が残されている。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記問題 点を解決するために鋭意研究を行い、特定のボリイミド /ビスマレイミド樹脂が170℃における十分な耐熱性 を有するとともに、アルミ、鉄等の金属およびFRP (繊維強化プラスチック)等の複合材料に対して強固な 接着性を有することを見出した。また、上記のボリイミ ド/ビスマレイミド樹脂は、良好な成形性、靱性をも併 せて有することを見出し、本発明を完成するに至った。 本発明は、高い耐熱性を有し、接着温度・接着圧力等の 成形性、接着性に優れたポリイミド/ビスマレイミド系 接着剤を提供することを目的とする。また、本発明は、 上述の諸特性を有するとともにタック性・ドレープ性等 の取扱作業性に優れたポリイミド/ビスマレイミド系接 着剤を提供することをも目的とする。また、本発明は、 こしやすいといった問題点がある。こうした問題を解決 50 上記の特性のほかに靱性に優れるポリイミド/ビスマレ

イミド系複合材料を提供すること、および機械的強度や 耐薬品性等のボリイミド/ビスマレイミド樹脂が有する 諸特性をも有し、航空宇宙分野等の先端技術分野におい て有用であるポリイミド/ビスマレイミド系複合材料を 提供することも目的とする。

【0007】すなわち、本発明の第一の態様は、(A) 下記一般式[1]で表される芳香族ビスマレイミド10 0重量部と、(B)下記一般式[2]で表されるアルケ ニルフェノール58~100重量部および(C)全重量 のうち50%以下1%以上のシロキサン単位が含まれて 10 いる下記一般式[3]で表されるシリコーンジアミンお よび他のジアミン成分と酸二無水物から合成される溶剤 可溶性ポリイミド10~100重量とを含有するフィル ム状接着剤、または織布あるいは不織布に浸漬したシー ト状接着剤である。

[0008]

【化10】

(式中、Xは、-CH2-、-C(CH3)2、-SO2-、-SO-、-CO-、 -S-生たは-O-を示す。)

[0009] 【化11】 $(R^1)_n$

(式中、R1 またはR2 は、それぞれ独立にアリル基を 30 表し、nは1~4の整数を表す。)

…式[2]

[0010]

【化12】

$$H_2N-R^3-SI-O-SI-R^4-NH_2$$
 R^6
 R^6
 R^5
 R^4-NH_2
 R^6
 R^6
 R^6
 R^6
 R^6
 R^6
 R^6

(式中、R3 およびR4 は、それぞれ独立に、炭素数1 ~5のアルキレン基、アラルキレン基およびアルケニレ ン基を表し、互いに同じであっても異なってもよいし置 40 換されていてもよい。R5 およびR6 は、それぞれ独立 に、炭素数1~14のアルキル基、アラルキル基、アル ケニル基およびアリール基を表し、互いに同じであって も異なってもよいし置換されていてもよい。nは1~1 00の整数を表す。)

【0011】また、本発明の第二の態様は、(A)上記 一般式[1]で表される芳香族ピスマレイミド100重 量部と、(B)上記一般式 [2]で表されるアルケニル フェノール58~100重量部および(C)全重量のう

上記一般式 [3] で表されるシリコーンジアミンおよび 他のジアミン成分と酸二無水物から合成される溶剤可溶 性ポリイミド10~100重量部を補強材に含浸させた プリプレグである。前記 (C)の溶剤可溶性ポリイミド は、粒径0.01~100 umの微粒子であるのが好ま しい。また、この微粒子は、接着剤中に均一に分散して いるのが好ましい。本発明の第三の態様は、(A)前記 式[1]で表される芳香族ピスマレイミド100重量部 と、(B) 前記(A) を溶解することのできる前記式 [2]で表されるアルケニルフェノール58~100重 量部および(C)全重量のうち50%以下1%以上のシ ロキサン単位が含まれている前記式 [3] で表されるシ リコーンジアミンおよび他のジアミン成分と酸二無水物 から合成される粒径0.01~100 mmの微粒子化し た溶剤可溶性ポリイミド10~100重量部とを混合し

6

【0012】以下、本発明について詳細に説明する。本 発明の第一の態様のフィルム状接着剤、またはシート状 接着剤は、芳香族ピスマレイミドと、アルケニルフェノ 20 ールと、溶剤可溶性ポリイミドとを含有することを特徴 とする。本発明において用いられる芳香族ビスマレイミ ドは、対応する芳香族ジアミンと無水マレイン酸とを反 応させる公知の方法により得ることができる。上記の芳 香族ビスマレイミドは、樹脂の反応性と機械的特性の点 から融点が170℃以下であってアルケニルフェノール 成分に可溶であるものが好ましい。

【0013】 芳香族ピスマレイミドとしては、N, N' ーmーフェニレンビスマレイミド、N,N'ーpーフェ ニレンビスマレイミド、N, N'-m-トルイレンビス マレイミド、N, N'-4, 4'-ピフェニレンピスマ レイミド、N, N'-4, 4'-(3, 3'-ジメチル ピフェニレン) ピスマレイミド、2,2-ピス[4-(4-マレイミドフェノキシ) フェニル] プロパンおよ び下記一般式[1]で表されるピスマレイミドなどを挙 げることができる.

[0014] 【化13】

てなる樹脂組成物である。

(式中、Xは、-CH2、-C(CH3)2、-SO2、-SO-、-CO-、 -S-または-O-を示す。)

【0015】上記一般式 [1]で表されるビスマレイミ ドとしては、例えば、N, N'-4, 4'-(3, 3' ージメチルジフェニルメタン) ビスマレイミド、N, ン) ビスマレイミド、N, N' -4, 4' -ジフェニル ち50%以下1%以上のシロキサン単位が含まれている 50 メタンビスマレイミド、N, N'ー4, 4'ー2, 2ー ジフェニルプロパンビスマレイミド、N, N'-4, 4'-ジフェニルエーテルビスマレイミド、<math>N, N'-3, 3'-ジフェニルスルホンビスマレイミド、<math>N, N'-4, 4'-ジフェニルスルホンビスマレイミド、<math>N, N'-4, 4'-iフェニルスルホキシドビスマレイミド、N, N'-4, 4'-iフェニルスルフィドビスマレイミド、N, N'-4, 4'-iフェニルスルフィドビスマレイミド、N, N'-4, 4'-i

【0016】中でも、N, N'-4, 4'-ジフェニル メタンビスマレイミド、N, N'-4, 4'-ジフェニ 10 ルエーテルビスマレイミド、N.N'-m-トルイレン ピスマレイミド、2,2ービス[4-(4-マレイミド フェノキシ) フェニル] プロパン、N, N'-4, 4' ージフェニルスルホンビスマレイミド、N, N'-4, 4'ーベンゾフェノンビスマレイミド等が硬化後の樹脂 の耐熱性の点で好ましい。特に、N, N'-4, 4'-ジフェニルメタンピスマレイミド、N, N'-4, 4' ージフェニルエーテルビスマレイミド、N, N'-m-トルイレンビスマレイミド、2,2-ビス[4-(4-マレイミドフェノキシ) フェニル] プロパンが好まし い、上述の芳香族ビスマレイミドは、単独で使用しても よく、また、2種以上を併用してもよい。アルケニルフ ェノールとの相溶性がよく、熱硬化性樹脂組成物の溶融 粘度を下げることができるという点で、融点が170℃ 以下のものを用いることが好ましい。

【0017】本発明において用いられるアルケニルフェ ノールは、下記一般式 [2]で表される化合物である。 【0018】

…式[2]

(式中、 R^1 または R^2 は、それぞれ独立にアリル基を表し、 R^1 もたは R^2 は、それぞれ独立にアリル基を表し、 R^2

【0019】ここで、R1 またはR2 は、それぞれ独立 にアリル基を表す。アリル基は、芳香環上の位置は特に 限定されないが、1~4個が環上で左右対象の位置に存 在することが好ましい。この理由は、硬化後の樹脂のガ ラス転移温度が高くなるからである。具体的には、2, 2'ージアリルピスフェノールA、4,4'ージヒドロ 40 キシー3.3'ージアリルジフェニル、ビス(4-ヒド ロキシー3ーアリルフェニル) メタン、2,2ービス (4-ヒドロキシー3, 5-ジアリルフェニル) プロパ ン、2, 2-ジアリルビスフェノールF等が挙げられ る。また、ポリフェノール類と、塩化アリルまたは臭化 アリルとの反応生成物のアリル化率がフェノール性OH 基に対して50%以上150%以下で、かつクライゼン 転移したアリル基がフェノール性OH基に対して20% 以上のアルケニルフェノールも使用することができる。 上述のアルケニルフェノールは、単独で使用してもよ

く、2種以上を併用してもよい。2、21-ジアリルビ スフェノールA、2、2-ビス(4-ヒドロキシー3, 5ージアリルフェニル) プロパン、2、2'ージアリル ビスフェノールF等が硬化後の樹脂のガラス転位温度が 高いため好ましく、特に、2、2'ージアリルビスフェ ノールA、2、2'ージアリルビスフェノールFがシリ コン変性ポリイミドとの相溶性がよいために好ましい。 【0020】本発明で用いるアルケニルフェノールは、 常温で液体あるいは粘性体であることが好ましい。アル ケニルフェノールが固体であると、本発明の第一の態様 のフィルム状およびシート状接着剤を製造した時のドレ ープ性やタック性が低下するためである。本発明の第一 または第二の態様において樹脂成分として使用するアル ケニルフェノールの配合量は、ビスマレイミド100重 量部に対して58~100重量部である。アルケニルフ ェノールの配合量をこの範囲としたのは、58重量部未 満では、ドレープ性やタック性が低下し、100重量部 を越えると機械的強度が低下するためである。58~9 3重量部であることが好ましく、特に、58~86重量 部であることが好ましい。

R

【0021】溶剤可溶性ポリイミドは、通常、酸二無水物とジアミンとを反応させて得られるボリアミック酸を、熱あるいは脱水剤の存在下でイミド閉環して得る。上記の溶剤可溶性ポリイミドは、Nーメチルー2ーピロリドン、N,Nージメチルホルムアミド等の有機溶剤に25℃で可溶であることが望ましい。特に、本発明において用いられるアルケニルフェノールに可溶であれば接着剤をシート化して半硬化状態で繊布あるいは不緻布に含浸できるため、作業性の点でいっそう好ましい。とりわけ、本発明で使用するアルケニルフェノールに室温では溶解せず、高温時(80℃~200℃位)に可溶であることが好ましい。その理由は、溶解することにより均一なミクロ相分離構造を呈するからである。

【0022】本発明の溶剤可溶性ポリイミドは、全重量のうち50%以下1%以上、好ましくは1~30%、より好ましくは5~20%のシロキサン単位を含む。シロキサン単位を含むことにより、シロキサン単位が有機溶剤への可溶性を向上させるとともにポリイミド自身に可機性を付与し、ビスマレイミド樹脂系に製性を与えるので被着体との接着強度を高めることが可能となるためである。また、溶剤可溶性ポリイミド中のシロキサン単位の量をこの範囲としたのは、前記ポリイミドの全重量のうちシロキサン単位が50%を越えると、耐熱性、強度が著しく低下するためである。

【0023】溶剤可溶性ポリイミドの合成に用いられる酸二無水物としては、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'ーベンゾフェノン50 テトラカルボン酸二無水物、4,4'ーオキシジフタル

酸二無水物、ナフタレン-2、3、6、7-テトラカル ボン酸二無水物、ナフタレン-1,2,5,6-テトラ カルボン酸二無水物、ナフタレン-1,2,4,5-テ トラカルボン酸二無水物、ナフタレン-1,4,5,8 ーテトラカルボン酸二無水物、ナフタレンー1,2, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物、3,3',4, 4'ージフェニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2',3,3'ージフェニルテトラカルボン酸二無水 物、2,3,3',4'-ジフェニルテトラカルボン酸 二無水物、2,2-ビス(2,3-ジカルボキシフェニ 10 ル) プロパン二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカル ボキシフェニル)プロパン二無水物、ビス(2,3-ジ カルボキシフェニル) エーテル二無水物、ビス(2,3 ジカルボキシフェニル)メタン二無水物、ビス(3) 4-ジカルボキシフェニル) メタン二無水物、ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) スルホン二無水物、 1, 1-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)エタン 二無水物、1,1-ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ル) エタン二無水物、チオフェン-2,3,4,5-デ トラカルボン酸二無水物などを挙げることができる。 【0024】中でも、3,3',4,4'ージフェニル テトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'ーベン ゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、4,4'-オキ シジフタル酸二無水物、ピス(3,4-ジカルボキシフ ェニル)スルホン二無水物等が生成するポリイミドがア ルケニルフェノールに可溶であるため好ましい。その理 由は、骨格が比較的に柔軟で結晶性が低いからである。 特に、3、3'、4、4'ージフェニルテトラカルボン 酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテト ラカルボン酸二無水物、4,4'-オキシジフタル酸二 30 無水物が、接着性の理由から好ましい。上述の酸二無水 物は、単独で使用してもよく、また、2種以上を組合わ せて用いてもよい。

【0025】本発明で用いる溶剤可溶性ポリイミドの合 成に用いられるジアミンは、全重量の50%以下のシロ キサン単位を含む(以下、シロキサン単位を含むジアミ ンをシリコーン変性ジアミンという)。このため下記一 段式[3]で表されるシリコーン変性ジアミンと他のジ アミン成分とを併用し、全重量の50%以下のシロキサ ン単位を含むようにする。

[0026]

【化15】

(式中、R3 およびR4 は、それぞれ独立に、炭素数1 ~5のアルキレン基、アラルキレン基およびアルケニレ ン基を表し、互いに同じであっても異なっていてもよい 独立に、炭素数1~14のアルキル基、アラルキル基、 アルケニル基およびアリール基を表し、互いに同じであ っても異なってもよいし置換されていてもよい。 nは1 ~100の整数を表す。)

10

【0027】R3 およびR4 は、シリコーン変性ジアミ ンの反応性を高めるために、それぞれ独立に、炭素数1 ~5のアルキレン基、アラルキレン基、アルケニレン基 であることが好ましく、互いに同じであっても異なって もよいし置換されていてもよい。特に、プロピレン基、 ブチレン基であることが好ましい。R5 およびR6 は、 生成したポリイミドの相溶性のために、それぞれ独立 に、炭素数1~14のアルキル基、アラルキル基、アル ケニル基およびアリール基であることが好ましく、互い に同じであっても異なっていてもよく、置換されていて もよい。特に、耐熱性の点で、メチル基、フェニル基で あることが好ましい。また、nは1~100であり、特 に、耐熱性、接着性、強度保持の点で、1~20である ことが好ましい。このようなシリコーンジアミンとして は、α、ωービスアミノポリジメチルシロキサンを挙げ 20 ることができ、具体的には、 α , ω -ビス(3-アミノ プロビル) ポリジメチルシロキサン、1,3-ビス(3 ーアミノプロピル) テトラメチルジシロキサン、α, ω ービス (3ーアミノプロピル) ポリメチルフェニルシロ キサン、 α , ω -ビス (3-アミノプロピル) ポリ (ジ メチルシロキサンージフェニルシロキサン) コポリマー が好ましい。他のジアミン成分と併用する場合には、 α, ω-ビス (3-アミノプロビル) ポリジメチルシロ キサン、1,3ービス(3ーアミノプロビル)テトラメ チルジシロキサン等のジアミンを選択することが好まし い。その理由は、接着性が向上するからである。

【0028】上記一般式[3]で表されるシリコーンジ アミン以外の他のジアミン成分としては、3,3'ージ メチルー4, 4' ージアミノビフェニル、4, 6ージメ チルーmーフェニレンジアミン、2,5-ジメチルーp ーフェニレンジアミン、2、4ージアミノメシチレン、 4,4'-メチレンジーロートルイジン、4,4'-メ チレンジー2,6ーキシリジン、4,4'ーメチレンー 2,6-ジエチルアニリン、2,4-トルエンジアミ ン、mーフェニレンジアミン、pーフェニレンジアミ 40 ン、4,4'ージアミノジフェニルプロパン、3,3' ージアミノジフェニルプロパン、4,4'ージアミノジ フェニルエタン、3,3'ージアミノジフェニルエタ ン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、3,3'ー ジアミノジフェニルメタン、4,4'ージアミノジフェ ニルスルフィド、3、3'ージアミノジフェニルスルフ ィド、4,4'-ジアミノジフェニルスルホン、3, 3'ージアミノジフェニルスルホン、4、4'ージアミ ノジフェニルエーテル、3,3'ージアミノジフェニル エーテル、3,4'ージアミノジフェニルエーテル、ベ し置換されていてもよい。R5 およびR6 は、それぞれ 50 ンジジン、3,3'-ジアミノビフェニル、3,3'-

ジメチルー4, 4'ージアミノビフェニル、3, 3'ー ジメトキシベンジジン、ビス (p-アミノシクロヘキシ ル) メタン、ビス (p-8-アミノーt-ブチルフェニ ル) エーテル、ビス (p-β-メチル-δ-アミノペン チル) ベンゼン、pービス (2-メチルー4-アミノペ ンチル) ベンゼン、p-ビス(1,1-ジメチル-5-アミノペンチル) ベンゼン、1,5-ジアミノナフタレ ン、2,6-ジアミノナフタレン、2,4-ビス(β-アミノーセーブチル)トルエン、2,4ージアミノトル エン、m-キシレン-2, 5-ジアミン、p-キシレン 10 -2、5-ジアミン、m-キシリレンジアミン、p-キ シリレンジアミン、2,6-ジアミノピリジン、2,5 ージアミノヒリジン、2,5ージアミノー1,3,4-オキサジアゾール、1,4-ジアミノシクロヘキサン、 ピペラジン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、ア ロピレンジアミン、2,2-ジメチルプロピレンジアミ ン、テトラメチレンジアミン、ベンタメチレンジアミ ン、ヘキサメチレンジアミン、2,5-ジメチルヘキサ メチレンジアミン、3ーメトキシヘキサメチレンジアミ ン、ヘプタメチレンジアミン、2,5-ジメチルヘプタ 20 メチレンジアミン、3ーメチルヘプタメチレンジアミ ン、4,4-ジメチルヘプタメチレンジアミン、オクタ メチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、5ーメチル ノナメチレンジアミン、2、5-ジメチルノナメチレン ジアミン、デカメチレンジアミン、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ) ベンゼン、2,2-ビス[4-(4 ーアミノフェノキシ) フェニル] プロパン、1,3ービ ス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、ビス~4-(4 ーアミノフェノキシ) フェニルスルホン、ピスー4ー (3-アミノフェノキシ)フェニルスルホンなどを挙げ 30 ることができる。

【0029】中でも、4、4'ージアミノジフェニルエ ーテル、3、3'ージアミノジフェニルエーテル、3、 4' -ジアミノジフェニルエーテル、4, 4' -ジアミ ノジフェニルスルホン、3,3'ージアミノジフェニル スルホン、1、3ーピス (3ーアミノフェノキシ) ベン ゼン、2、2ービス[4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル] プロパン、1,3-ビス(4-アミノフェノキ シ) ベンゼン、ビスー4ー (4-アミノフェノキシ) フ ェニルスルホン、ビスー4ー(3ーアミノフェノキシ) 40 フェニルスルホン等が好ましく、1,3-ビス(3-ア ミノフェノキシ) ベンゼン、ビスー4ー(4ーアミノフ ェノキシ) フェニルスルホン、2, 2-ビス [4-(4 ーアミノフェノキシ) フェニル] プロパンが特に好まし い。上述のシリコーン変性ジアミンおよび他のジアミン は、単独で用いてもよく、二種以上を組合わせて用いて もよい。

【0030】イミド化の際に使用する有機溶剤は、特に れがあるため、トルエン、キシレン、ソルベントナフヤ 限定されないが、非プロトン性極性溶媒が好ましく、こ 等の芳香族炭化水素を使用することが好ましい。また、 の種の代表的な溶媒としては、N, Nージメチルホルム 50 イミド化反応の触媒として、無水酢酸、βーピコリン、

アミド、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージエチルホルムアミド、N, Nージエチルアセトアミド、N, Nージメチルスルホトキシア・セトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルフォスホアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ピリジン、ジメチルスルホン、テトラメチルスルホン、ケーブチロラクトン、ジグライム、テトラヒドロフラン、塩化メチレン、ジオキサン、シクロヘキサノン等を挙げることができる。N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジグライム、テトラヒドロフラン等がポリアミック酸をかなりの量まで均一溶解できるため好ましい。特に、Nーメチルー2ーピロリドン、N, Nージメチルホルムアミドが、生成するポリイミドの溶解性が良好であるために好ましい。

【0031】上記の非プロトン性極性溶媒は、単独、あるいは二種以上を組み合わせた混合溶媒として使用してもよい。また、上記非プロトン性極性溶媒と相溶性がある非極性溶媒を混合して用いてもよい。トルエン、キシレン、ナフザ等の芳香族炭化水素がこのような貧溶媒としてよく使用され、ポリアミック酸を均一に溶解できる範囲で、押散調節剤、被膜平滑剤等として使用することもできる。上述にような非極性溶媒の混合溶媒中の量は、30重量%以下であることが好ましい。非極性溶媒が30重量%を越えると溶媒の溶解力が低下し、ポリアミック酸が析出するおそれがあるためである。

【0032】本発明の溶剤可溶性ボリイミドの合成は、公知の方法で行なうことができる。具体的には、予め、酸二無水物成分あるいはよく乾燥したジアミン成分の何れか一方を脱水精製した有機溶剤中に溶解、あるいは懸濁しておき、他方の成分を粉末、液状あるいは有機溶剤に懸濁した状態で徐々に添加する。この混合反応は発熱を伴うため、望ましくは冷却しながら反応系の温度を室温付近に保つ。酸二無水物成分とジアミン成分のモル比は当量付近、特に0.7~1.3の範囲にあることが望ましい。モル比をこの範囲としたのは、何れか一方が多くなり過ぎると、重合後のボリアミック酸の分子量が大きくならず、耐熱性、機械的特性が低下するためである。

【0033】上述のようにして酸二無水物成分とジアミン成分を室温付近で反応させ、ポリアミック酸を合成し、得られたポリアミック酸を有機溶剤中で加熱脱水湿化してイミド化し、ポリイミドにする。イミド化反応によって生じた水は反応を妨害するため、水と相溶しない有機溶剤を系中に加えて共沸させ、ディーンースターク(Dear-Stark)管等の装置を用いて生成された水を系外に排出する。水と相溶しない有機溶剤としては、ジクロロベンゼンが知られているが、塩素成分が混入するおそれがあるため、トルエン、キシレン、ソルベントナフサ等の芳香族炭化水素を使用することが好ましい。また、イミドル反応の触媒として、無水産酸、8ーピコリン

ピリジン等を用いてもよい。

【0034】本発明に使用する溶剤可溶性ポリイミド は、上述のようにして合成する。この溶剤可溶性ポリイ ミドを微粒子化する方法としては、粉砕機により粉砕 し、分級して微粒子化する方法、および、上記のように 合成した溶剤可溶性ポリイミドを溶剤に溶解し、貧溶媒 に再沈殿させることによって、微粒子化する方法等があ る。 微粒子化して加えると、 ピスマレイミドとアルケニ ルフェノールの混合物中に均一に分散させることができ る。均一に分散させることにより、接着剤として充分な 10 タック性 (粘着性) が得られる。特に、粒径0.01~ 100μmのものが好ましい。より好ましくは、0.1 ~80µm、さらに好ましくは、0.5~50µmであ る。粒径が0.01 μm未満では増粘してタック性が損 なわれ、また、100μm超では高温において相溶化す る時に濃度ムラ等が生じる原因となって接着不良を招 く。また、フィルム化あるいはシート化時に均質形成を 損ない、プリプレグや樹脂組成物を硬化したときに強度 低下等の問題が生じるためである。

【0035】本発明の樹脂成分として使用する溶剤可溶 20 性ポリイミドの配合量は、微粒子化されている場合にも されていない場合にも、ピスマレイミド樹脂100重量 部に対して10~100重量部である。好ましくは、2 0~100重量部、より好ましくは、40~100重量 部である。溶剤可溶性ポリイミドの配合量をこの範囲と したのは、10重量部未満であると接着性向上効果およ び靱件向上効果が発現されず、100重量部を越えると ビスマレイミド樹脂が本来有する耐熱性が低下するため である。

【0036】本発明の第一の態様の接着剤を得るには、 通常、アルケニルフェノールに上記のように合成した溶 剤可溶性ポリイミドと芳香族ピスマレイミドを加え、必 要に応じて有機溶剤等で希釈して粘度を調節し、室温か ら170℃の間の温度で均一に加熱混合して本発明の樹 脂とし、フィルム成形機等を用いてフィルム化する。特 に、微粒子化した溶剤可溶性ポリイミドを使用する場合 には、微粒子化した溶剤可溶性ポリイミドが溶解しない 温度で均一に分散混合する。織布あるいは不織布に浸漬 したシート状接着剤を製造するには、上記のようにフィ ルム化した後、2枚あるいはそれ以上の枚数のフィルム で上記の基材を気泡が残らないように挟んで製造する。 【0037】本発明において、フィルム成形時またはプ リプレグ成形時に用いられる有機溶剤は、上記のように して合成した本発明のポリイミド/ビスマレイミド樹脂 を均一に溶解できるものであれば特に限定されるもので はないが、具体的には、N. Nージメチルホルムアミ ド、N、Nージメチルアセトアミド、N、Nージエチル ホルムアミド、N、Nージエチルアセトアミド、N、N ージメチルメトキシアセトアミド、ジメチルスルホキシ ド、ヘキサメチルホスホアミド、N-メチル-2-ピロ 50 雑、アラミド繊維、ガラス繊維等を用いたときに効果が

リドン、ピリジン、ジメチルスルホン、テトラメチルス ルホン、ァーブチロラクトン、ジグライム、テトラヒド ロフラン、塩化メチレン、ジオキサン、シクロヘキサノ ン等を挙げることができる。高沸点の溶剤を多量に用い ると接着不良あるいはボイド等による成形不良の原因と なるため低沸点の溶剤を使用することが好ましく、テト ラヒドロフラン、塩化メチレン、ジオキサン、シクロへ キサノン等を使用することが好適である。これらの有機 溶剤は、単独で使用してもよく、また、二種類以上を併 用した混合溶媒として使用してもよい。既に述べたよう に、上記の樹脂を均一に溶解できる範囲で、貧溶媒を揮

14

【0038】総布あるいは不総布に浸漬したシート状接 着剤を製造するために使用する基材としては、耐熱性が あり、表面処理が容易であるために、ガラス基材が好ま しい。ガラス基材は、平織、綾織、平がらみ織、4枚朱 子織、8枚朱子織等の織布であってもよく、マット、ヤ ーン、チョップ状等の不識布を使用してもよい。さらに これらの基材は、単独で用いてもよく、また、2種以上 を組み合わせて使用してもよい。特に、平織、マット等 を基材として用いると効果が著しい。

散調節剤などとして使用することもできる.

【0039】上述のようにして作製した本発明の第一の 態様の接着剤は、被接着体の間に挟み、加熱硬化する。 本発明の第一の態様の接着剤を用いる被接着体として は、アルミ、鉄、銅等の金属、FRP (fiber reinforc ed plastic、繊維強化プラスチック)等の複合材料が好 ましく、特に、アルミ、鉄、FRP等の接着剤として用 いると効果が著しい。また、本発明の第一の態様の接着 剤に使用する樹脂は、被接着体の接着面に直接塗布し、 被接着体を互いに接着した後に加熱硬化することもでき る。

【0040】本発明の第二の態様のアリアレグは、通 常、アルケニルフェノールに上記のように合成した溶剤 可溶性ポリイミドと芳香族ビスマレイミドを加えて、必 要に応じて有機溶剤等で希釈して粘度を調節し、室温か ら170℃の間の温度で均一に加熱混合して本発明の樹 脂とする。特に、微粒子化した溶剤可溶性ポリイミドを 使用する場合には、微粒子化した溶剤可溶性ポリイミド が溶解しない温度で均一に分散混合する。その後、下記 の補強材料を使用し、プリプレグ成形機等を用いてプリ プレグ化し、得られたプリプレグを積層し、加熱硬化し て成形する。

【0041】本発明の第二の態様のプリプレグに用いる 補強材料は、耐熱性繊維であることが好ましく、具体的 には、炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維、ボロン繊 雄、シリカ繊維等を挙げることができる。これらの繊維 は、長繊維、短繊維のいずれであってもよく、繊布、不 織布を使用してもよい。これらの補強材は、単独で使用 しても、2種以上を併用してもよいが、特に、炭素繊

著しい。

【0042】本発明の第三の態様の樹脂組成物は、成分 (A) の芳香族ビスマレイミドを溶解できる成分(B) を用いること、微粒子化した溶剤可溶性ポリイミドを用 いることが特徴であり、通常、アルケニルフェノールに 上述のように微粒子化した粒径0.01~100μmの 溶剤可溶性ポリイミドと芳香族ピスマレイミドを加え て、必要に応じて有機溶剤等で希釈して粘度を調節し、 微粒子化した溶剤可溶性ポリイミドが溶解しない温度で 均一に分散混合して本発明の樹脂組成物とする。このよ 10 うにして得られた樹脂組成物は均質であるので、耐熱 性、靱性等の特性に優れ、そのまま加熱硬化して樹脂材 として用いたり、上述のようにフィルム状接着剤あるい はシート状接着剤として使用したり、また、プリプレグ として用いる事ができる。そのまま加熱硬化して樹脂組 成物として用いる場合には、一般的な樹脂の成形法によ り行うことができるが、プレス成形、RTM (Resin Tr ansfer Molding)等の方法で成形することが、切削等の 二次加工を必要としないために好ましい。

[0043]

【実施例】以下に実施例をもって本発明を一層具体的に 説明するが、本発明はこれらにより何等限定されるもの ではない。

【0044】(溶剤可溶性ポリイミドの合成例)温度 計、攪拌機、原料投入口、乾燥窒素ガス導入管を備えた 四ツロのセパラプルフラスコ中に、1,3-ビス(3-アミノフェノキシ) ベンゼン (ABP) 20. 46g (0.07モル)、下記式[4]で表されるシリコーン ジアミン8.56g(0.03モル)を300gのN-メチルー2-ピロリドン (NMP) に溶解した。4, 4'-オキシジフタル酸無水物 (ODPA) 31.02 g(0.1モル)を30分かけて粉状のまま徐々にこの 溶液に添加した後、2時間攪拌を続けた。操作は乾燥窒 素ガス気流下で行い、さらにODPAを添加する前から 氷浴で冷却し、系を反応中20℃に保持した。次いで、 この系にキシレン60gを添加し、乾燥窒素導入管を外 して代わりにディーンースターク還流冷却管を取り付 け、氷浴を外してオイルバスで加熱して系の温度を上昇 させた。

【0045】閉環反応によるイミド化に伴って生じる水 40 をキシレン共沸させて系外へ除去しながら攪拌を続け、 150~160℃でイミド化を進めた。 水が発生しなく なった5時間後に反応を終了させ、ポリイミドワックス を得た。得られたポリイミドワックスを、30リットル のメタノール中に撹拌しながら1時間かけて滴下し、樹 脂を沈殿させ、沪過して固形分のみを回収した。回収し た樹脂を真空乾燥機中にて減圧下120℃で5時間乾燥 させ、ポリイミド樹脂を得た。このようにして得られた ポリイミド樹脂のFT~IRスペクトルを測定し、16

吸収スペクトルと、1780cm-1に現われるイミド環 に基づく吸収スペクトルからイミド化率を求めた。これ らの吸収スペクトルの比較より分子内のアミド結合は、 100%イミド化されていることがわかった。シロキサ ン単位(SiO)の含有量は、全重量の15%であっ た。以下、実施例の説明中、および表の説明においてシ

16

[0046] 【化16】

リコーン変性ポリイミドと略す。

【0047】(実施例1~6)表1に示す量の2.2' ーアリルビスフェノールAに、N, N', 4, 4'ージ フェニルメタンピスマレイミドと上記のように合成した シリコーン変性ポリイミドとを表1に示す量添加して1 20℃で30分間撥拌混合し、フィルム化装置を用いて 20 接着剤フィルムを作製した。このフィルムをガラス織布 (商品名: Style 101、有沢製作所製) にプレ スを用いて含浸させ接着剤シートとした。接着剤シート の重量は415g/m²とした。これらの接着剤を被接 着体であるアルミ平板の間に挟んで、オートクレーブを 用いて、180℃、3気圧で3時間硬化した後、227 ℃、大気圧で6時間後硬化を行い、物性評価試験用試験 片を作製した。

【0048】 (実施例7~10) 上述のようにして合成 したシリコーン変性ポリイミドを分級機内蔵ジェット粉 30 砕機により粉砕し、粒子径が1~33µmの微粒子を分 級して得た。N, N', 4, 4'ージフェニルメタンビ スマレイミドと、2、2'ージアリルピスフェノールA を室温にて3本ロールを用いて各々表2に示す量で混合 し、その混合物に上述のように粉砕分級して得た微粒子 化シリコーン変性ポリイミドを表2に示す量室温で混合 した、実施例1~6と同様にして実施例7~10の接着 剤シートとした。接着剤シートの重量および硬化は実施 例1~6と同様に行い、物性評価試験用試験片を得た。 【0049】(実施例11~16)表3に示す量の2. 2'-アリルビスフェノールAに、N, N', 4, 4' ージフェニルメタンピスマレイミドとシリコーン変性ポ リイミドの合成例で合成したポリイミドとを表3に示す 量添加して120℃で30分間攪拌混合し、マトリック ス用樹脂を作製した。この樹脂を、高強度中弾性炭素繊 雑(トレカT800H-12K-40B、東レ(株) 製)にプリプレグ化装置を用いて含浸させ、一方向プリ プレグを作製した。このプリプレグの炭素繊維目付は1 45g/m²、樹脂含有率は36重量%とした。このプ リプレグから所定の小片 (40×40cm)を切り出 50cm~1 に現われるイミド化前のアミド結合に基づく 50 し、上記炭素繊維の方向を、+45°、0°、−45

*、90*にして、4層×4回積層し、次に、90*、 -45°、0°、+45°にして、4層×4回積層後、 オートクレーブを用いて180℃、7気圧で3時間硬化 し、物性評価試験用試験片を作製した。

【0050】 (実施例17~20) 上述のようにして得 られたシリコーン変性ポリイミドを分級機内蔵ジェット 粉砕機により粉砕し、粒径が1~33μmの微粒子を分 級して得た。N, N', 4, 4'-ジフェニルメタンビ スマレイミド、2,2'-ジアリルビスフェノールAを 表4に示す量用いて室温にて3本ロールを用いて混合し 10 た。その混合物に上述のように粉砕分級した微粒子化シ リコーン変性ポリイミドを表4に示す量室温で混合し、 マトリックス用樹脂を作製した。この樹脂を、実施例1 1~16と同様にして補強材に含浸させ、一方向プリプ レグを作製し、積層硬化して物性評価試験用試験片を得 た。

【0051】(比較例1~4)4,4'ージフェニルメ タンビスマレイミド、2,2'ージアリルビスフェノー ルAおよび上述のようにして合成したシリコーン変性ボ リイミドを表1に示す量用いて、実施例1~6と同様に 20 して比較例1~4の接着剤シートとし、実施例1~6と 同様に硬化させて物性評価試験用試験片を得た。

【0052】(比較例5~6)実施例7~10で使用し たシリコーン変性ポリイミドを表2に示す量使用する他 は、実施例7~10と同様にして比較例5および6の接 着剤シートとし、加熱硬化して物性評価試験用試験片を 得た。

【0053】(比較例7~10) N, N', 4, 4'-ジフェニルメタンピスマレイミド、2,2'ージアリル ビスフェノールAおよびシリコーン変性ポリイミドを表 30 【0056】 3に示す量添加する他は、実施例11~16と同様にし て比較例7~10のプリプレグとし、オートクレーブ成

18

形も同様に行い物性評価試験用試験片を得た。

【0054】(比較例11および12) N, N', 4, 4'ージフェニルメタンビスマレイミド、2,2'ージ アリルビスフェノールAおよびシリコーン変性ポリイミ ドを表4に示す量添加し室温にて3本ロールを用いて混 合する他は実施例11~16と同様にして比較例11お よび12のプリプレグを作製し、オートクレーブ成形も 同様に行って物性評価試験用試験片を得た。

【0055】(物性評価)

(1)接着試験

接着強度は、ドラムビール強度、および室温 (23℃) と高温(170℃)それぞれにおける引張剪断強度によ って評価した。ドラムピール強度はASTM D178 1-76に準じて試験し、引張剪断強度はASTM D 1002に準じて行った。

(2) タック性の判定

官能判定法を用いて、実施例および比較例の各シート表 面を手指および掌で触れ、判定した。表2中、〇はタッ ク性良好を意味し、×はタック性不良を意味する。

(4)衝擊後圧縮強度試験

SACMA (Supplies of Advanced Composites Materi als Association) リコメンディッド メソッド SR M2-88 (Recommended Methods SRM2-88) に準拠して 1,500lb-in/in衝撃後の圧縮強度を測定し

(3)ガラス転移点の測定

真空理工社製TM-3000熱機械試験機を用いて硬化 物の熱膨張曲線によりガラス転移点を測定した。結果を 表1~表4に示す。

【表1】

20

			块轴的1	埃納到 2	実施例3	实施例4	实施例5	实施贸6	Harry 1	比較到2	比較例3	比較多4
	4 イービスマレ ジフェニルメ		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
成収	2 ダージアリル ビスフェノー		75	75	75	75	5.8	100	75	75	40	120
Ħ	シリコーン 変性 ポリイミド		10	44	75	100	10	10	0	175	10	10
物	ドラムピール社 Orgf in/in)	读	1. 2	2. 2	8. 0	8. 2	1. 3	1. 6	0. 4	6. 0	0. 4	0. 5
性		本 里	440	422	538	521	552	401	377	508	5 6 Q	25 1
K	(logi/cm²)	170 °C	383	369	467	443	528	387	415	168	555	102
	ガラス転移型数	E (JB)	287	274	257	254	290	275	288	151	287	211

41:マトリミド52824 (チバ・ガイギー社製) 42: マトリミド52828 (チバ・ガイギー社製)

[0057]

20【表2】 表 2

			実施例?	实验例 8	实施例 9	美数 010	比較 95	H#2948
超成	4 イービスマレイミドー ジフェニルメタン 4		100	100	100	100	100	100
成成	2 ダージアリルー		75	75	75	75	75	75
₩	機栓子化シリコ ポリイミ		10	44	75	100	0	175
	接着剤のタック	性	0	0	0	0	0	×
物性	ドラムビール独変 Ong! in/ia)		1. 0	1. 5	7. 8	7. 7	0. 3	7. 2
社	Grand (Control of Control of Cont	塑	453	451	442	442	353	392
		170 °C	418	4 4 3	458	413	375	142
	ガラス配移型	E (Te)	287	276	277	256	288	156

41;マトリミド5292A (チバ・ガイギー社製) 42; マトリミド5292B (チバ・ガイギー社製)

[0058]

※ ※【表3】

		奥勒例 11	実施例12	実施的3	実施例4	実施的15	実施例16	出的97	Harrin 8	14365919	£££\$£\$010
_	4 イービスマレイミドー ジフェニルメタン 村	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
成成	2. セージアリルー ビスフェノールA 42	75	75	75	75	58	100	75	75	40	120
∌	シリコーン 変性 ポリイミド	10	44	75	100	10	100	0	175	10	10
物性試	Orge /mm²)	14. 7	15. 6	20. 0	19, 7	18.0	19. 2	12. 3	18. 2	14. 3	8. 8
W	ガラス転移温度 (Tg)	288	285	267	261	287	255	289	158	289	210

41:マトリミド52924 (チバ・ガイギー社製)

42; マトリミ 152928 (チバ・ガイギー社製)

[0059]

* *【表4】

		実施例17	実施例18	実施例19	実施例20	比較例11	比較例12
粗	4 イービスマレイミドー ジフェニルメタン *1	100	100	100	100	100	100
成成	2 ダージアリルー ビスフェノールA 42	75	75	75	7 5	75	75
B	微粒子化シリコーン変性 ポリイミド	10	44	75	100	0	175
	プリプレグのタック性	0	0	0	0	0	×
物性試験	病學後日齡%度 (ligf /mm²)	14. 1	16. 0	19. 4	19. 5	12. 8	18, 7
験	ガラス転移温度(Tg)	285	286	262	260	286	154

*1:マトリミト5292A (チバ・ガイギー社製)

42; マトリミド52928 (チバ・ガイギー社製)

【0060】表1に示すように、実施例1~6のフィル ム状接着剤は、十分なドラムビール強度を示し、室温に 度の大きな低下は認められなかった。ガラス転移点も2 50℃以上であり、靱性、耐熱性に優れることが示され た。一方、シリコーン変性ポリイミドの配合量が本発明 の範囲外であると、ドラムピール強度が低下したり、ガ ラス転移点の大幅な低下、あるいは高温における引張剪 断強度の大幅な低下が起こった(比較例1および2)。 また、2, 2'ージアリルビスフェノールAの配合量が 本発明の範囲外である場合にも、比較例1および2と同 様の結果が示された(比較例3および4)。表2に示す

※実施例7~10の接着剤は、実施例1~6の接着剤と同 様十分なドラムピール強度を示し、引張剪断強度も高温 おける引張剪断強度も大きく、高温における引張剪断強 40 と室温でほとんど変化しなかった。ガラス転移点も高 く、また、タック性も良好であった。一方、シリコーン 変性ポリイミドの配合量が本発明の範囲外であると、ド ラムヒール強度の低下、あるいは高温における引張剪断 強度の大幅な低下、あるいはガラス転移点の低下等が生 じていた(比較例5および6)。

【0061】表3に示すように、実施例11~16のプ リプレグは、衝撃後圧縮強度、ガラス転移点ともに良好 な値を示し、耐衝撃性、朝性に優れることが示された。 シリコーン変性ポリイミドの配合量が本発明の範囲外で ように、微粒子化シリコーン変性ポリイミドを使用した※50 あると、衝撃後圧縮強度が上がらなかったり、ガラス転

移点が低下した(比較例7および8)。また、2、2、 ージアリルビスフェノールAの配合量が本発明の範囲外 であると、衝撃後圧縮強度あるいはガラス転移点が低下 した(比較例9および10)。表4に示すように、微粒 子化シリコーン変性ポリイミドを使用した実施例17~ 20のアリプレグは、衝撃後圧縮強度も十分で、ガラス 転移点も高く、耐衝撃性および制性に優れることが示さ れた。シリコーン変性ポリイミドの配合量が本発明の範 囲外であると、衝撃後圧縮強度の低下、あるいはガラス 転移点の低下が見られた。

[0062]

【発明の効果】本発明によれば、耐熱性、成形性、タック性およびドレーア性等の取扱性に優れ;アルミ、鉄等の金属やFRP等の複合材料の接着にも優れ、かつ室温のみならず170℃のような高温においても十分なビー

ル強度、引張剪断強度を有するフィルム状接着剤および シート状接着剤を得ることができる。また、耐熱性、成

24

形性、タック性およびドレーブ性等の取扱性、報性等に 優れるFRP複合材料を得ることができる。さらに、本 発明の樹脂組成物は、上記一般式 [1]で表される芳香 族ピスマレイミドと、上記一般式 [2]で表されるアル ケニルフェノールと、全重量のうち50%以下1%以上 のシロキサン単位を含む、上記式 [3]で表されるシリ

コーンジアミンおよび他のジアミン成分と酸二無水物か

10 ら合成される粒径が100μm以下の微粒子化された溶 剤可溶性ポリイミドを混合してなるため、フィルム状接 着剤またはシート状接着剤とするときに、高温における 相溶化時に濃度ムラ等を起こすことがなく、良好な接着

性を得ることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

CO9J 7/04

JJU JKD

// C09J 171/00

JFW

(72)発明者 高津戸 敏 一

神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株式会社平塚製造所内

(72)発明者 竹田 敏郎

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住 友ベークライト株式会社内

(72)発明者 榎 尚 史

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号 住 友ベークライト株式会社内